

●2026 年度精密工学会春季大会特別シンポジウム 第 4 弾（参加費無料，事前申込制）

「半導体製造装置開発の最前線」

～業界トップクラスの技術者が登壇 技術をわかりやすく解説します～

半導体はあらゆる産業の活動を支える技術基盤を提供しています。生成 AI の発展や自動車の知能化を始め、DX の急速な拡大と高度化によって、その役割は増すばかりです。今日の半導体にはナノメートルサイズの 3 次元構造が組み込まれており、微細化と高集積化において、終わりのない進化を続けています。

本シンポジウムでは、日本半導体製造装置協会(SEAJ)のご協力により、世界トップレベルの技術力とシェアをもつ日本の半導体製造装置メーカーの研究者に講演いただきます。

はじめに、基調講演として Rapidus 株式会社 常務執行役員 赤堀浩史氏より、先端半導体製造の現状と課題、さらには、半導体産業の未来像、産業全体が向かうべき方向性について講演いただきます。

シンポジウムでは、半導体製造装置の最新制御技術、AI/DX を駆使した先端技術開発など、半導体製造に欠かせない技術分野の最新の研究開発や課題を解説していただきます。

学会の研究者・技術者の方々には、様々な点で興味深いニーズやシーズを見つけていただけたと思います。また、学生さんには魅力や親近感を感じていただけたと思います。学会とは近そうで少し疎遠でもあった半導体製造技術分野との繋がりのお機会になれば幸いです。

日 時：2026 年 3 月 17 日(火) 13:30～16:00 （受付開始:13:00～）

会 場：埼玉大学 全学講義棟 1 号館 3F301（春季大会会場内）

司 会：岩本花子(株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ)

次 第：

時 間	題 目	内 容	講 師
13:30	主催者挨拶	精密工学会より	精密工学会会長 山内 和人
基調講演			
13:35～14:30	「Rapidus が目指す先端半導体製造の現状と課題」 ～ 精密プロセスを支える管理・制御技術 ～		Rapidus 株式会社 常務執行役員 赤堀 浩史
シンポジウム			
14:35～15:00	半導体製造装置の最新制御技術	講演名「装置制御技術を対象とする MBD 教育の産学連携」 概要:SEAJ では、半導体製造装置制御を対象とする MBD*人材育成の産学連携を進めており、その概要を紹介します ※MBD は「モデルベース開発」です	アズビル株式会社 技術開発本部 基幹技術部 田中 雅人
15:00～15:25	AI/DX を駆使した先端技術開発	講演名「複雑化する半導体製造プロセスへの取り組み」 概要:複雑化・微細化・高積層化する半導体デバイスの製造プロセスと、プロセス開発効率やデバイス生産効率を向上するためのデータ駆動型アプローチをご紹介します	東京エレクトロン株式会社 コーポレート技術本部 革新技術開発センター 装置開発部 田中 尚人
15:25～15:40	Q&A セッション	質疑応答など、不明なところや疑問点を説明します (スマートフォンアプリ“Slido”を用います)	本日の講師とともに
15:40～15:45	分科会について	半導体製造技術ネットワーク分科会について	分科会主査 長谷川 功宏
15:45	共催挨拶	日本半導体製造装置協会より	日本半導体製造装置協会 専務理事 渡部 潔
15:50	閉会の挨拶	精密工学会より	精密工学会副会長 松村 隆

【連携企画】 新技術講演会(技術賞受賞講演) : 16:15～18:00

同日 16:15 から同会場にて「新技術講演会(精密工学会技術賞受賞講演)」を予定しています。合わせてご参加ください。

主催:公益社団法人 精密工学会(JSPE)

共催:一般社団法人 日本半導体製造装置協会(SEAJ)

参 加 費:無料, 事前申込制

申込方法:ホームページ(<https://2026-03spring.jspe.or.jp/semiconductor-sympo/>)

または、右の QR コードからお申込み下さい。

申込み期限:2026 年 3 月 4 日(水)

申 込 先:公益社団法人 精密工学会(URL:<https://www.jspe.or.jp/>)

お申込み

